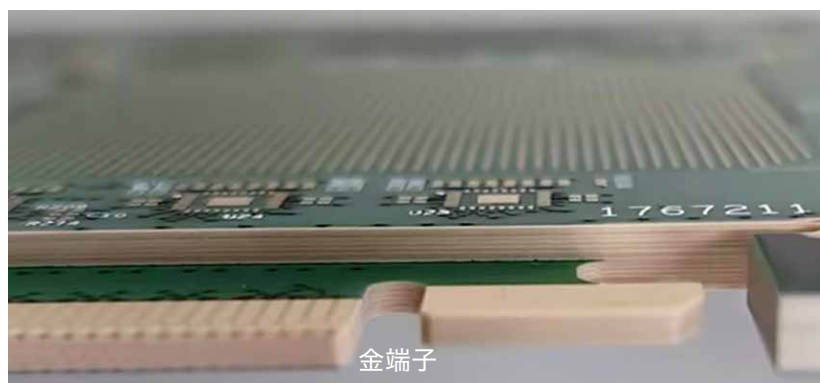
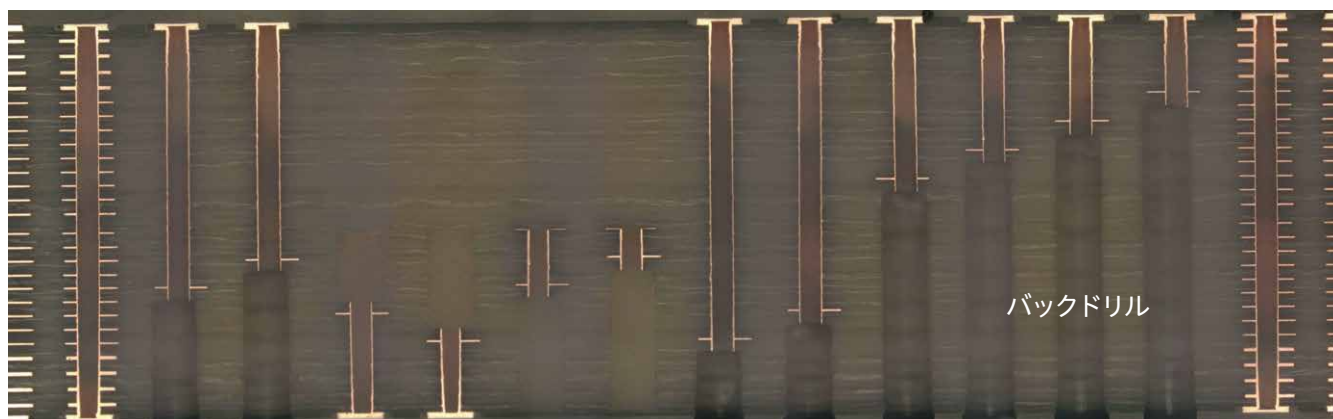


AIサーバー対応高密度多層基板

28層+Backdrill+複合板厚端子金対応

特長 Features

- バックドリルによるビアスタブ除去により信号特性向上
- 1枚の基板内での板厚制御によりPCI-e規格の金端子に対応
- 各種高周波材料に対応



設計仕様

材料型番	EM-890K
層構成	28L (14L+14L)
板厚 (mm)	3.424mm
L/S (μm)	95/76
TH/Pad (mm)	0.2/0.4825
THアスペクト比	17
表面処理	電解金+無電解金

層構成

層番号	層名	材料	厚さ (mm)	処理
1	銅箔	銅	0.035	無電解金
2	銅箔	銅	0.035	無電解金
3	銅箔	銅	0.035	無電解金
4	銅箔	銅	0.035	無電解金
5	銅箔	銅	0.035	無電解金
6	銅箔	銅	0.035	無電解金
7	銅箔	銅	0.035	無電解金
8	銅箔	銅	0.035	無電解金
9	銅箔	銅	0.035	無電解金
10	銅箔	銅	0.035	無電解金
11	銅箔	銅	0.035	無電解金
12	銅箔	銅	0.035	無電解金
13	銅箔	銅	0.035	無電解金
14	銅箔	銅	0.035	無電解金
15	銅箔	銅	0.035	無電解金
16	銅箔	銅	0.035	無電解金
17	銅箔	銅	0.035	無電解金
18	銅箔	銅	0.035	無電解金
19	銅箔	銅	0.035	無電解金
20	銅箔	銅	0.035	無電解金
21	銅箔	銅	0.035	無電解金
22	銅箔	銅	0.035	無電解金
23	銅箔	銅	0.035	無電解金
24	銅箔	銅	0.035	無電解金
25	銅箔	銅	0.035	無電解金
26	銅箔	銅	0.035	無電解金
27	銅箔	銅	0.035	無電解金
28	銅箔	銅	0.035	無電解金

